

**SEMICON JAPAN 2008 出展いたしました**  
(小間番号:2C-705/Hall2)

**SEMICON<sup>®</sup>**  
**Japan2008**

当社は、12月3日(水)～5日(金)の3日間、幕張メッセにおいて開催される『[セミコン・ジャパン2008](#)』に出展し、国内最大の実績を有する当社の半導体装置のリース・ファイナンス事業と、[スミックス株式会社](#)の中古半導体装置売買事業、そして同社の誇る技術サービス事業とのコラボレーションにより推進しているトリニティー・サービスについてご紹介いたしました。

多数のご来場、誠にありがとうございました。。



今年の様子

【開催概要】

名称 : [セミコン・ジャパン2008](#)  
会期 : 2008年12月3日(水)～5日(金) 10:00-17:00  
会場 : 幕張メッセ 千葉市美浜区中瀬2-1  
(1～11ホール、イベントホール、国際会議場) 小間番号:2C-705 ホール2  
主催 : SEMI (Semiconductor Equipment and Materials International)

お問合せ窓口  
三井住友ファイナンス&リース株式会社  
電子デバイス設備部  
TEL: 03-3515-1940 / FAX: 03-3515-1959  
Mail: [semicon@smfl.co.jp](mailto:semicon@smfl.co.jp)

以 上